

NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

* 2018 年 5 月 2 日に発表されたプレスリリースの抄訳です

**タワージャズ、巨大パワー製品市場に対応した 16V までの電圧帯を用いる
最先端 300mm 65nm BCD パワーマネージメントプラットフォームを発表**

**業界最高水準のプラットフォームが数十億ドル規模の最大電圧 16V のアプリケーション向け
パワーマネージメント IC 市場に画期的なパフォーマンスとコストメリットを提供**

ミグダルハエメク(イスラエル)、2018 年 5 月 2 日 - グローバルスペシャルティファウンドリーリーダーの[タワージャズ](#)は本日、最大 16V で動作し、24V 耐圧のデバイスを搭載する最先端のパワーマネージメントプラットフォーム、300mm 65nm BCD (Bipolar-CMOS-DMOS) プロセスを発表しました。生産拠点は富山県魚津市で、当社の 300mm 65nm 車載認証済みフローを基盤に、業界最高水準の品質とサイクルタイムを提供します。

このプラットフォームは、PMIC、ロードスイッチ、DC-DC コンバーター、LED ドライバー、モータードライバー、バッテリーマネジメント、アナログ/デジタルコントローラーなど、アプリケーションを問わず電圧 16V までのあらゆるタイプのパワーマネージメントチップの競争力を大幅に強化します。調査会社 IHS マークイットのパワー IC 担当アナリスト、Kevin Anderson 氏は、この技術が対応する市場の規模は 2018 年で 94 億ドルにのぼり、その後も拡大が続くと予測しています。

タワージャズの 65nm BCD プロセスは、最高の省電力性、極めて小型のダイ、最高のデジタル搭載能力、そして最小面積と最少マスク枚数との相乗効果による優れた費用対効果で、この低電圧パワー市場セグメントを牽引します。

このプロセスには、5V、7V、12V、16V で動作する 4 種類の最先端パワー LDMOS トランジスタが搭載され、それぞれ現時点で最高レベルのオン抵抗と Qgd パラメーターを備えています。前述したコストや性能優位性に加え、複数のチップを単一のモノリシックな IC ソリューションに統合でき、従来のマルチチップモジュール構成に比べてシステムのコスト構造およびパフォーマンス改善が可能となります。

タワージャズのパワートランジスタは分離性能に優れているとともに、オン抵抗も 5V LDMOS に対して $1\text{m}\Omega \cdot \text{mm}^2$ 未満と極めて低く、メガヘルツ (MHz) 級のスイッチング周波数で動作する製品に対しても、65nm BCD パワートランジスタの Qgd が $2.6\text{m}\Omega \cdot \text{nC}$ と非常に低いことが利点です。さらに、1 層もしくは 2 層の $3.3\mu\text{m}$ 厚の Cu 配線層を使用することで、極めて低い配線抵抗を実現しています。また 65nm BCD は、5V 系でアグレッシブな $113\text{Kgate}/\text{mm}^2$ 、1.2V 系は $800\text{Kgate}/\text{mm}^2$ のデジタルライブラリを提供します。

タワージャズのパワーマネージメントおよびミックスドシグナル/CMOS ビジネスユニット担当のバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー、Shimon Greenberg 氏は次のように述べています。「この新しい 65nm BCD プラットフォームは、16V までの電圧帯のパワーアプリケーション向け成長市場における、タワージャズの技術的リーダーとしての地位を確立するものです。低電圧パワーマネージメントという巨大な市場セグメントに注力している当社には、早期導入を目指すお客様から非常に高い関心が寄せられており、2018 年第 4 四半期までに量産体制を整備する計画です」

タワージャズは、2018 年 5 月 13 日から 17 日までシカゴで開催される第 30 回パワー半導体デバイスおよび IC 国際シンポジウム (ISPSD) に出展します。

タワージャズの 65nm BCD 技術の詳細は、<http://www.towerjazz.com/power-management.html> をご覧ください。

タワージャズについて

タワーセミコンダクター株式会社 (NASDAQ: TSEM, TASE:TSEM) は、その子会社とタワージャズというブランド名でグローバルに事業を展開するスペシャルティファンドリのリーダーです。タワージャズは、コンシューマー、産業機械、車載用、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で次世代の集積回路 (IC) を生産しており、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、パワーマネージメント (BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やキャパシティ拡大を必要とするファブレス企業向けには Transfer Optimization and development Process Services (TOPS) を提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワージャズはイスラエルに 2 か所 (150mm と 200mm)、米国に 2 か所 (200mm)、日本に 3 か所 (200mm と 300mm) の生産拠点を保有しています。詳細は www.towerjazz.com をご覧ください。

TowerJazz Company Contact: Lauri Julian | +1 949-280-5602 | lauri.julian@towerjazz.com

TowerJazz Investor Relations Contact: Noit Levi | +972-4-604-7066 | noit.levi@towerjazz.com